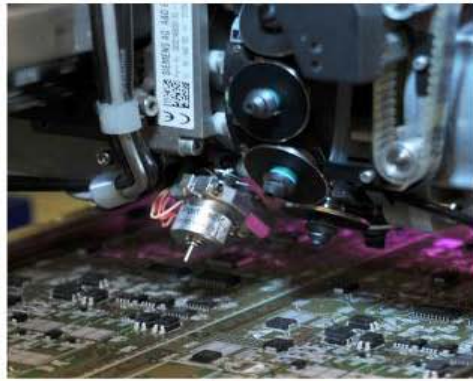
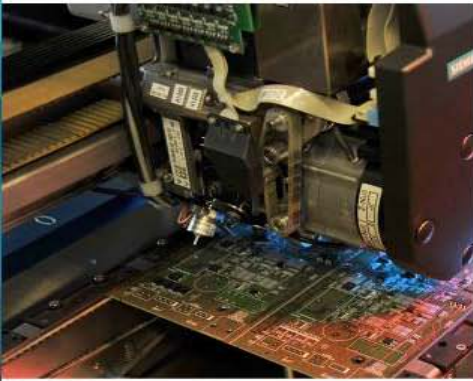


SIEMENS

Embedded Electronics for Industry



The title is centered in a white box at the top left. The background of the slide features a close-up, angled view of a green printed circuit board (PCB) with various components and labels like 'REL1', 'D5', 'D1', and 'R2'.**Challenge:**

- Parametrierbare Lösung zur Fernsteuerung und Fernüberwachung von digitalen und analogen Signalen über GSM

Solution:

- ARM9 Controller mit digitalen und analogen Ein- und Ausgängen
- „state of the art“ GSM-Engine

Benefit:

- Reduzierung des Serviceaufwandes durch neues flexibles Fernüberwachungssystem für Anlagen und Systeme
- Durch Batteriebetrieb auch für Überwachungen bei Netzausfall geeignet
- Einfache Parametrierung durch mitgelieferte Software

The main title of the slide is 'ICP/Wireless-Solution: PROFINET - Systemfamilie', presented in a bold, black, sans-serif font on a white background.

ICP/Wireless-Solution: PROFINET - Systemfamilie

The 'Challenge:' section header is in a bold, black, sans-serif font.

Challenge:

- Hohe Industrieanforderungen – bei > 50%-iger Preisreduzierung
- Entwicklung von zwei Systemfamilien auf Basis einer Plattform

The 'Solution:' section header is in a bold, black, sans-serif font.

Solution:

- Einfache Montage
- Optimiert für DFT und DFM
- Hohe Bauteileintegration

The 'Benefit:' section header is in a bold, black, sans-serif font.

Benefit:

- Kompakte Bauform mit 5/8 Port
- Unverkennbare „Corporate Identity“
- Einstieg in das industrielle Low Cost Segment